

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公開番号】特開2000-151086(P2000-151086A)

【公開日】平成12年5月30日(2000.5.30)

【出願番号】特願平10-320839

【国際特許分類第7版】

H 05 K 3/34

【F I】

H 05 K 3/34 501 E

H 05 K 3/34 505 C

H 05 K 3/34 512 C

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月2日(2005.11.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0022】

図1の(A)において、はんだを含むはんだペースト24をプリント回路基板10の第1の電極12に印刷する。すなわち、第1の電極12に対応する開口部26aを有するマスク26をプリント回路基板10の上に配置し、はんだペースト24をマスク26の上にのせ、スキージ28をマスク26の表面に沿って滑らせ、はんだペースト24をマスク26の開口部26aに充填する。マスク26をプリント回路基板10から取り外すと、はんだペースト24がプリント回路基板10の第1の電極12の上に印刷される。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

図1の(B)において、QFP16をプリント回路基板10に搭載する。この場合、QFP16のリードピン18がプリント回路基板10の第1の電極12の上のはんだペースト24の上に載るようにQFP16をプリント回路基板10に対して位置合わせし、QFP16のリードピン18をはんだペースト24aによってタッキングし、赤外線ランプ30を照射することによってはんだペースト24aをリフローする。すると、QFP16のリードピン18ははんだペースト24に含まれるはんだ24aによってプリント回路基板10の第1の電極12に接続される。なお、図には1つのQFP16のみが示されているが、リードピン18と同様のリードピンを有するその他のQFP及び表面実装部品をQFP16と同時にプリント回路基板10に搭載することができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図7

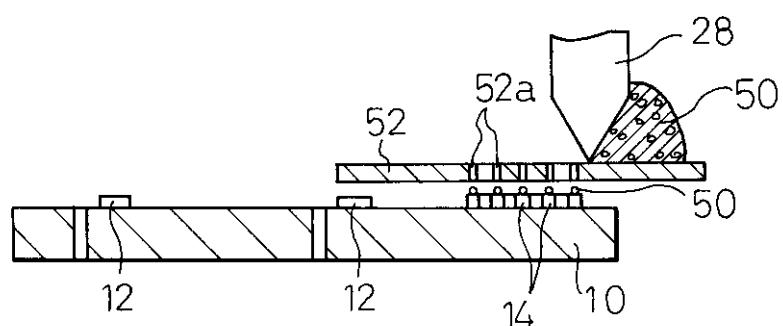
【補正方法】変更

【補正の内容】

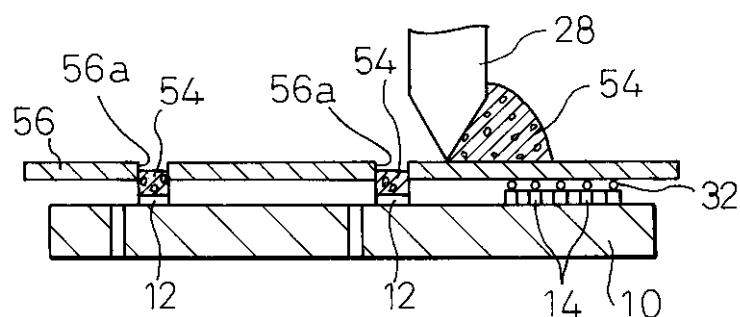
【図7】

図7

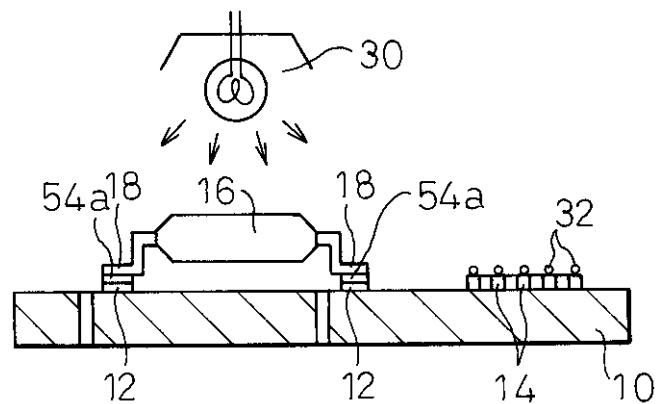
(A)



(B)



(C)



(D)

